

第 85 類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

注

- 1 この類には、次の物品を含まない。
  - (a) 電気加熱式の毛布、ベッドパッド、足温器その他これらに類する物品並びに電気加熱式の衣類、履物、耳当てその他の着用品及び身辺用品
  - (b) 第 70.11 項のガラス製の物品
  - (c) 第 84.86 項の機器
  - (d) 内科用、外科用、歯科用又は獣医科用に使用する種類の真空装置（第 90.18 項参照）
  - (e) 第 94 類の電気加熱式家具
- 2 第 85.01 項から第 85.04 項までには、第 85.11 項、第 85.12 項又は第 85.40 項から第 85.42 項までの物品を含まない。

ただし、金属槽水銀アーク整流器は、第 85.04 項に属する。
- 3 第 85.07 項の「蓄電池」には、エネルギーを蓄積及び供給する蓄電池の機能に貢献し又は蓄電池を損傷から保護する補助部品（例えば、接続子、温度制御装置（サーミスター等）及び回路保護装置）とともに提示するものを含むものとし、また、蓄電池が使用される物品の保護ハウジングの一部を取り付けたものを含む。
- 4 第 85.09 項には、通常家庭で使用する種類の次の電気機械式機器のみを含む。
  - (a) 床磨き機、食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機（重量を問わない。）
  - (b) その他の機器で重量が 20 キログラム以下のもの

ただし、ファン及びファンを自蔵する換気用又は循環用のフード（フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。第 84.14 項参照）、遠心式衣類脱水機（第 84.21 項参照）、皿洗機（第 84.22 項参照）、家庭用洗濯機（第 84.50 項参照）、ロール機その他のアイロンがけ用機械（第 84.20 項及び第 84.51 項参照）、ミシン（第 84.52 項参照）、電気ばさみ（第 84.67 項参照）並びに電熱機器（第 85.16 項参照）を除く。
- 5 第 85.23 項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
  - (a) 「不揮発性半導体記憶装置」（例えば、「フラッシュメモリーカード」又は「フラッシュ電子記憶カード」）は、接続用ソケットを備え、同一ハウジングの中に、印刷回路基板上に集積回路の形で搭載している一以上のフラッシュメモリー（例えば、「FLASH E<sup>2</sup>PROM」）を有している。これらは、集積回路の形状をしたコントローラー及び個別の受動素子（例えば、コンデンサー、抵抗器）を取り付けたものを含む。
  - (b) 「スマートカード」とは、内部にチップ状の集積回路（マイクロプロセッサ、ランダムアクセスメモリー（RAM）又はリードオンリーメモリー（ROM））を 1 個以上埋め込んだものをいう。これらのカードは、接触子、磁気ストリップ又はアンテナを取り

付けたものを含むものとし、その他の能動又は受動回路素子を有するものを含まない。

6 第 85.34 項において「印刷回路」とは、印刷技術（例えば、浮出し、めつき及びエッチング）又は膜回路技術により、導体、接触子その他の印刷した構成部分（例えば、インダクター、抵抗器及びコンデンサー。電気信号の発生、整流、変調又は増幅を行うことができる素子（例えば、半導体素子）を除く。）を絶縁基板上に形成して得た回路（当該構成部分をあらかじめ定めたパターンに従って相互に接続してあるかないかを問わない。）をいう。

印刷回路には、印刷工程中に得た素子以外の素子を結合した回路並びに個々の抵抗器、コンデンサー及びインダクターを含まないものとし、印刷してない接続用部品を取り付けてあるかないかを問わない。

これらの技術により得た薄膜回路及び厚膜回路で、受動素子と能動素子とから成るものは、第 85.42 項に属する。

7 第 85.36 項において、「光ファイバー（束にしたものを含む。）用又は光ファイバーケーブル用の接続子」とは、デジタル回線システムにおいて、光ファイバーの端と端を単に機械的に接合させる接続子をいう。これらは、その他の機能（例えば、信号の増幅、再生又は変調）を有しない。

8 第 85.37 項は、テレビジョン受像機その他の電気機器の遠隔操作のコードレス赤外線装置を含まない（第 85.43 項参照）。

9 第 85.41 項及び第 85.42 項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(a) 「ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス」とは、その働きが電界の作用に基づく抵抗率の変動により行われる半導体デバイスをいう。

(b) 「集積回路」とは、次の物品をいう。

(i) モノリシック集積回路（半導体材料又は化合物半導体材料（例えば、ドーブ処理したけい素、ガリウム-砒素、シリコン-ゲルマニウム、インジウム-りん等）の基本的には内部に又は当該材料の表面に、回路素子（ダイオード、トランジスター、抵抗器、コンデンサー、インダクター等）を生成させ、かつ、不可分の状態にした回路）

(ii) ハイブリッド集積回路（単一の絶縁基板（ガラス製のもの、陶磁製のもの等）上に、受動素子（薄膜技術又は厚膜技術によつて作られた抵抗器、コンデンサー、インダクター等）と能動素子（半導体技術によつて作られたダイオード、トランジスター、モノリシック集積回路等）とを相互接続子又は接続ケーブルによつて実用上不可分の状態に組み合わせた回路）。この回路には、個別部品を取り付けたものを含む。

(iii) マルチチップ集積回路（二以上の相互に接続したモノリシック集積回路が、実用上不可分の状態に組み合わされた回路。絶縁基板が一以上であるかないか、また、リードフレームがあるかないかを問わないものとし、その他の能動又は受動回路素子を含まない。）

- (iv) マルチコンポーネント集積回路 (MCO) (一以上のモノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路又はマルチチップ集積回路と、少なくとも一のコンポーネント (シリコンベースセンサー、シリコンベースアクチュエーター、シリコンベースオシレーター、シリコンベースレゾネーター若しくはこれらを組み合わせたもの、第 85.32 項、第 85.33 項若しくは第 85.41 項に属する物品の機能を有するコンポーネント又は第 85.04 項に属するインダクター) とを結合した回路で、ピン、リード、ボール、ランド、バンプ又はパッドを通して、印刷回路基板 (PCB) その他のキャリア上への組立てに使用する種類の部品として、集積回路と同様に実用上不可分の状態に一体化されているもの)

この定義において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

- 1 「コンポーネント」は、個別部品であるか、独立して製造された後に MCO の土台の上に組み立てられているか又は他のコンポーネントに組み込まれているかを問わない。
- 2 「シリコンベース」とは、シリコン基板上に形成され、シリコン材料で作られ又は集積回路ダイの上に製造されていることをいう。
- 3 (a) 「シリコンベースセンサー」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気特性の変化又は機械構造体の変位によつて生ずる物理量又は化学量を検出し、これらを電気信号に変換する機能を有するものである。「物理量又は化学量」は、圧力、音波、加速度、振動、移動、方向、歪<sup>ひず</sup>み、磁界強度、電界強度、光、放射能、湿度、フロー、化学物質濃度等の実世界の現象に関連する。
- (b) 「シリコンベースアクチュエーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気信号を物理的な動きに変換する機能を有するものである。
- (c) 「シリコンベースレゾネーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、外部入力に応じて、これらの構造体の物理的形狀に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電氣的な振動を発生する機能を有するコンポーネントである。
- (d) 「シリコンベースオシレーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、これらの構造体の物理的形狀に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電氣的な振動を発生する機能を有する能動コンポーネントである。

この注 9 の物品の所属の決定に当たっては、第 85.41 項及び第 85.42 項は、第 85.23 項を除き、当該物品が特にその機能からみて属するとみられるこの表の他のいずれの項にも優先する。

- 10 第 85.48 項において「使用済みの一次電池及び蓄電池」とは、破損、分解、消耗その他

の理由により本来の用途に使用することができず、かつ、充電する能力を有しないものをいう。

号注

- 1 第 8527.12 号には、高さ、幅及び奥行の寸法が 170 ミリメートル、100 ミリメートル及び 45 ミリメートル以下のカセットプレーヤー（増幅器を自蔵するもので、拡声器を組み込まず、かつ、外部電源によらずに作動するものに限る。）のみを含む。